**学习进步或工作内容**

1. 从我主要的工作内容、从软件开发的角度来讲；最先着手工作时，只是完成功能、没有bug
2. 熟悉工作内容后，有意识提升自测意识，确保完全测试功能后再提测，bug数量明显下降。
3. 此外，注意代码的整洁、易读性，封装UI组件、业务逻辑，进行复用；
4. 然后，进一步的优化组件，注意组件跨项目的复用性好不好、针对未来业务需求改变的灵活性 。

譬如：封装时采用了函数的写法，在形参过多时，代码显得不够清晰，尤其在后期在功能上修改时，可能牵涉到其他形参的位置变化，造成维护上的麻烦

1. 接着，额外找资料，看一些大厂的组件的规范，发现自己没有想到的地方，防止闭门造车，例如：将属性配置写在一个对象里，只能从这个对象里取。防止直接书写属性、容易出错。

此外，系统性地学习工作相关的知识，拓展深度，为未来发展做准备。我是报了一个网课，可以结构性地进行查漏补缺

1. 在课程的学习中，了解到框架的高阶用法。例如使用  react的 context API

项目亮点：需要根据打开的页面动态修改布局里的文字展示。使用它，在子组件中对父组件的修改。

Prolayout中，页面即子组件，无法使用传统的传参方式将修改父组件的方法传递进来

如果不使用这个方法，就不能使用prolayout，而是为每个页面单独写一个UI样式相同的布局

1. 部门贡献

包括在课程的学习中，了解到大厂的前端脚手架已把前端的数据拉取、状态管理，优化成一个单独的模块，做到逻辑下沉，使得项目的层级结构更清晰。

那么在这方面，公司还处于空白的状态，已经向组长进行反馈，看后续是否会在这方面进行优化和处理

研究搭建框架在数据模块的优化升级，使用状态机管理统一网络请求，独立拆分网络模块对象，把所有的数据请求都维护在一起。

1. 在工作中，察觉到很多业务线上的项目，在用户交互上都比较粗糙，可能会导致用户在使用软件时，体验感不好

于是，主动地去检索和查找如何改善用户体验

发现了在前端方面，谷歌团队提出的以用户为中心的性能模型--RAIL

该模型提倡让用户成为性能工作的中心，围绕的思想是“用户不是在等待加载，而是在使用时等待响应”，即“最快不一定是最好”

最近在做网页生成word的功能时，就用到了这个思想。

因为需要将部分内容生成图片后插入word中，导致加载很慢。但是直接加loading状态时，按钮的loading状态的渲染会被生成word的工作卡住，在页面上有非常明显的卡顿感。

于是，把生成word的工作延后200毫秒，等按钮的loading样式渲染完成后，才继续进行word生成工作

虽然生成的时间延长了一些，但是从用户角度，用户采取动作和得到响应之间没有出现断层，用户没有察觉到延迟，网页是流畅的

如果没有了解过这一点，虽然文件生成速度快了一些，但用户体验很差的

**沟通交流**

1. 在原型评审中，与产品经理沟通

更注重理解系统的整体逻辑，积极反馈项目中业务逻辑的可能问题，譬如在专家后台系统中向产品经理反应成果模块的逻辑问题，意见被采取并进行了修复。

1. 项目合作

重构关键核心技术攻关专家后台的前四大功能模块的代码，解决之前多人赶工时遗留下的状态冗余、请求参数传递整个列表的字段、未复用共性业务组件、部分问题解决方式粗糙等问题

之后，自己负责的项目，会提前写好共性组件、公共样式，在文档里标记清楚，并在组员开发前与对方交代清楚

1. 驻场开发

需要与多方进行即使的沟通交流

**课题申报书**

投标课题（严格），自选课题

活页：选题依据，研究内容，思路方法

选题依据

文献综述： 学术源头、近5年、最新

选题价值 ：

理论价值：围绕核心概念阐述，有逻辑分析的理论背景，不能自造概念；

应用价值 -- 问题意识，新问题 旧问题 热点问题

研究内容：研究对象、总体框架、重难点、主要目标

思路方法：

实证类：量化研究--调查、试验；质性研究--个案、行动

思辨类：经验总结、理论推演

混合方法：量化研究和质性研究的混合

创新点：

理论创新：新的学术思想、观点

资料创新：新材料、新证据等全新的数据

方法创新：对解决问题提出新方法、新途径

**项目报告**

是根据项目记录整理而成的有关项目实际情况或特殊问题的说明文件

可以是正式或非正式

是项目沟通计划实施过程中使用最多的项目沟通方式和文件

种类：项目绩效报告、项目总结报告、项目预测报告等

**项目十大知识领域**

项目整合管理、项目范围管理、项目进度管理、项目成本管理、项目风险管理

**集成电路**

集成电路（Integrated Circuit，IC）产业是信息技术产业的基础和核心，是现代电子工业的核心领域之一，它涉及到设计、制造和应用各种集成电路芯片。

**产业的主要内容：**

1. \*\*芯片设计（IC Design）\*\*：核心环节之一。包括从需求分析、电路设计、验证仿真到版图设计等多个环节，最终形成一个完整的芯片设计方案。设计的内容涵盖功能有：数字信号处理、模拟电路、射频电路、混合信号电路等。

2. \*\*芯片制造（IC Manufacturing）\*\*：芯片制造是将设计好的芯片方案转化为实际的硅片（Wafer）。这个过程包括光刻、薄膜沉积、离子注入、蚀刻、化学机械抛光等多道工艺。最终在硅片上形成各种功能的芯片结构。

3. \*\*封装测试（IC Packaging and Testing）\*\*：制造好的芯片需要进行封装和测试。封装是将硅片切割成单个芯片并封装到塑料或者陶瓷封装体中，以便于与外部连接。测试则是对芯片的功能、性能、可靠性等进行验证和测试，确保芯片符合设计要求。

4. \*\*应用领域（Application）\*\*：集成电路被广泛应用于各个领域，包括通信、计算机、消费电子、汽车、工业控制、医疗健康等。例如，通信领域使用的基带芯片、射频芯片、光通信芯片；消费电子领域使用的处理器芯片、图形芯片、传感器芯片等。

5. \*\*产业链\*\*：集成电路产业链包括芯片设计公司、芯片制造厂商、封装测试厂商、成品厂商、销售商等多个环节，形成了一个完整的产业生态系统。

6. \*\*技术创新\*\*：集成电路产业一直处于技术创新的前沿，随着科技的发展，不断涌现出新的芯片技术、新的工艺技术、新的设计方法等，推动着产业的不断发展。

总的来说，集成电路产业涵盖了芯片设计、制造、封装测试以及各个应用领域，是现代电子工业中最为重要和核心的领域之一。

**集成电路产业前景和行业背景的主要方面：**

1. \*\*技术创新\*\*：，随着微电子技术、半导体材料技术、芯片设计技术等的不断进步，新一代芯片产品不断涌现，如5G通信芯片、人工智能芯片、物联网芯片等，这些新技术的应用将为集成电路产业带来新的增长点。

2. \*\*应用领域不断拓展\*\*：包括通信、计算机、消费电子、汽车、工业控制、医疗健康等。随着智能手机、智能穿戴设备、智能家居、智能汽车等产品的普及，对集成电路产业的需求将持续增长。

3. \*\*政策扶持和投资推动\*\*：各国政府对于集成电路产业的发展十分重视，纷纷出台政策扶持和投资引导措施，鼓励企业加大研发投入，提升产业技术水平，推动产业健康发展。

4. \*\*产业链完善\*\*：集成电路产业的发展离不开完善的产业链，包括芯片设计、制造、封装测试等环节。随着产业链的不断完善和各环节技术的进步，集成电路产业将更加成熟和健康。

5. \*\*国际竞争日益激烈\*\*：集成电路产业是全球性的竞争性产业，各国企业在技术创新、市场拓展、资本运作等方面都展开了激烈的竞争。中国作为全球最大的电子消费品市场之一，也在积极推动本土集成电路产业的发展，加大了国际竞争力。

总的来说，集成电路产业在技术创新、应用领域、政策扶持等方面都有着良好的发展前景，但也面临着国际竞争激烈、技术变革快速等挑战，需要不断提升自身的技术水平和市场竞争力，以适应行业发展的变化和挑战。